

2026 年 8 月 6 日

各 位

会社名 ニッパツ（日本発条株式会社）
証券コード 5991（プライム市場）

ニッパツ、半導体プロセス部品の需要拡大に対応した生産能力増強投資を決定

ニッパツ（本社：横浜市、代表取締役社長：上村和久）は、半導体製造装置向け半導体プロセス部品の中長期的な需要拡大を見据え、伊勢原工場および宮田工場において追加の設備投資を実施することといたしました。

1. 投資の背景

当社は、2019 年 4 月に宮田工場を新設以降、需要拡大に対応するため段階的に生産能力を増強してまいりました。2024 年には同工場を拡張し、供給体制の強化を図っております。

近年、生成 AI の普及やデータセンター投資の拡大などを背景に半導体市場は成長を続けており、半導体プロセス部品への需要も拡大しております。

こうした市場環境を踏まえ、生産能力の増強を実施いたします。

2. 投資の内容

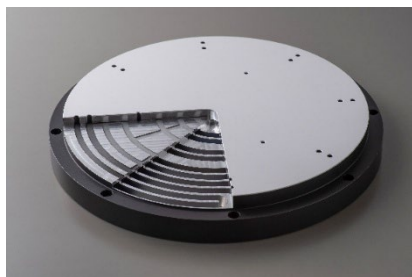
伊勢原工場および宮田工場において、生産設備の増強を実施いたします。

投資総額は約 60 億円を予定しており、設備導入は、2027 年度より順次実施いたします。

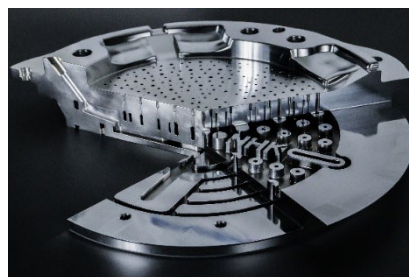
また、将来の更なる需要拡大に対応するため、用地確保や新建屋建設を含む段階的な能力増強投資についても検討を進めており、今後の追加投資も含め、半導体プロセス部品全体の生産能力を現状比 2 倍とすることを目指しております。

3. 概要

- | | |
|-------------|--------------------------------|
| (1) 対 象 拠 点 | 伊勢原工場、宮田工場 |
| (2) 所 在 地 | 神奈川県伊勢原市、長野県上伊那郡宮田村 |
| (3) 投 資 額 | 約 60 億円 |
| (4) 設備導入時期 | 2027 年度より順次実施予定 |
| (5) 生 産 品 目 | 半導体プロセス部品（冷却板、シャワーヘッド、ステージヒータ） |



（冷却板）



（シャワーヘッド）



（ステージヒータ）

【本件に関する問い合わせ先】

ニッパツ 企画管理本部 I R・広報部 Tel. 045-786-7513

以 上